

Presse À Chaud Automatique Sous Vide 10T Pour Pressage De Laboratoire De Précision

Numéro d'article: XP32



Introduction

Presse à chaud automatique sous vide de paillasse haute précision 10T avec plateaux chauffants 200x200mm et pompe à vide rapide pour le durcissement de polymères, le collage d'électrodes de batterie et la recherche sur les matériaux. Idéale pour les environnements de laboratoire nécessitant un chauffage uniforme et un contrôle de pression précis, certifiée CE avec écran tactile programmable.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Laminage de films polymères	Stratification de feuilles ou films polymères sous chaleur et vide pour créer des structures multicouches.	La pression et la température uniformes préviennent la déformation et les vides.
Collage d'électrodes de batterie	Collage de matériaux d'électrode sur des collecteurs de courant pour batteries lithium-ion ou à l'état solide.	La purge par gaz inerte empêche l'oxydation, assurant une conductivité élevée.
Compaction de poudres (avec matrices)	Compaction de poudres métalliques, céramiques ou composites en pastilles denses à l'aide d'une matrice plus petite.	Pression élevée jusqu'à 50,9 MPa réalisable avec une matrice de Ø50 mm.
Traitement de couches minces	Durcissement et recuit de couches minces pour applications électroniques et de capteurs.	Contrôle précis de la température jusqu'à 300°C avec environnement sous vide.
Frittage de céramiques	Frittage en phase initiale de corps céramiques verts sous chaleur et pression combinées.	Porosité réduite et propriétés mécaniques améliorées.
Durcissement de matériaux composites	Durcissement de préimprégnés composites en fibre de carbone ou de verre.	La répartition uniforme de la pression assure la qualité du laminage.
Encapsulation d'électronique organique	Encapsulation de dispositifs électroniques organiques sensibles sous atmosphère inerte.	L'environnement sans oxygène prolonge la durée de vie des dispositifs.

Paramètre	Spécification	Notes
Modèle	XP32	Presse à chaud sous vide automatique
Pression de travail maximale	≤ 10 Tonnes (100 kN)	Contrôlée via système programmable
Précision de pression	± 0,1 Tonne (1 kN)	Retour de charge haute précision
Température de travail du plateau	Température ambiante (TA) – 300 °C	Écran tactile PID programmable
Puissance de chauffage	3500 W	Réseau d'éléments chauffants haute densité
Dimensions du plateau	200 mm × 200 mm	Plateaux rectifiés à plat
Ouverture du plateau (Jour)	50 mm	Ouverture compacte pour cycle de vide rapide
Pompe à vide incluse	Pompe mécanique à palettes rotative	Inclusion standard
Déplacement de la pompe à vide	240 L/min (8,5 CFM)	Capacité d'évacuation à haute vitesse

Paramètre	Spécification	Notes
Niveau de vide ultime	< -0,1 MPa	Pression relative manométrique
Atmosphère de travail	Azote (N ₂) / Argon (Ar)	Compatible vide-et-purge
Alimentation électrique	AC 208V / 60Hz (Monophasé)	Optimisée pour les installations institutionnelles américaines
Certification	Certifié CE	Conformité de sécurité standard

Option	Contrôleur standard (Inclus)	Mise à niveau PLC industriel avancé (Optionnel)
Interface	Écran tactile couleur 7 pouces	PLC industriel Siemens avec écran tactile haute résolution
Fonctions principales	Profilage de température PID basique, saisie de pression cible, maintien automatique, décompression temporisée automatisée	Profilage température/pression multi-étapes complexe, stockage de recettes (jusqu'à 99 profils), retour de cellule de charge de précision, enregistrement de données Ethernet
Idéal pour	Laminage standard, durcissement de polymères, pressage simple de pastilles	Recherche académique, normes de test ASTM, processus nécessitant une compensation de pression étape par étape précise